

Presse-Information

Erweiterungen für ICS- und ME-IO-Tragschienen-Busverbinder

(02/24) Phoenix Contact bietet mit den Gehäuseserien ME-IO und ICS ein umfangreiches Portfolio für die Geräteentwicklung. Mit den neuen Erweiterungsartikeln für die Tragschienen-Busverbinder lässt sich noch einfacher ein Gesamtsystem aus mehreren Modulen umsetzen.

Manche Applikationen benötigen Daten und Signale aus der Modulkommunikation auch außerhalb des Modulverbunds, etwa bei einem Zeilensprung. Hier verbinden Einspeise- und Abgriffsteckverbinder für den achtpoligen Tragschienen-Busverbinder Module über mehrere Ebenen. Diese Stecker lassen sich sowohl linksseitig, mittig als auch rechtsseitig in den Geräteverbund einsetzen. Über den FMC-Strecker werden die Pole im Feld verkabelt.

Für Geräteanwendungen, bei denen kein Abgang zur Leiterplatte benötigt wird, kann die Übertragung von Daten und Signalen durch eine Brücke für Tragschienen-Busverbinder unterhalb des Moduls durchgeschleift werden. Somit wird die maximale Leiterplattenfläche genutzt.

5609 Bitte bei Kennziffer-Veröffentlichungen für die Leserdienst
 Zuordnung angeben

Presse-Information

Extensions for ICS and ME-IO DIN rail connectors

(02/24) With the ME-IO and ICS housing series, Phoenix Contact offers a comprehensive portfolio for device development. The new extension items for the DIN rail connectors make it even easier to implement an entire system consisting of several modules.

Some applications also require data and signals from the module communication beyond the module network, for example, in the case of a line feed. Here, input and output connectors for the eight-position DIN rail connector connect modules over several levels. These connectors can be inserted into the device group on the left, in the middle, and on the right. The positions in the field are cabled via the FMC connector.

The transmission of data and signals for device applications without a necessary output to the PCB can be looped through by a bridge for DIN rail connectors below the module. This means that the maximum PCB surface is used.

5609